

总部

中国·天津
天津空港经济区航空路53号

销售请联系:info@memsic.com

无锡研发、运营、制造中心

中国·江苏
江苏省无锡市新吴区新辉环路2号

电话: +86-510-66616668
销售请联系:info@memsic.com

上海研发、应用开发、销售支持中心

中国·上海
上海市浦东新区盛夏路666号盛银大厦E座5层505室

电话: 021-62330696
销售请联系:info@memsic.com

深圳应用开发、销售支持中心

中国·深圳
深圳市宝安区前海卓越时代广场A座1901B

电话: 0755-23306109
销售请联系:info@memsic.com

美国设计中心

美国·圣何塞
2570 North First Street, Suite 300, San Jose, CA 95131

电话: +1-408-637-5503
销售请联系:info@memsic.com

欧洲设计中心

荷兰·恩斯赫德
Pantheon 6A - 7521 PR Enschede

销售请联系:info@memsic.com

台湾销售支持中心

中国·台湾
台湾新竹县竹北市复兴三路二段168号6楼699室2号

电话: +886-3-6210447
销售请联系:info@memsic.com

扫码关注公众号



WWW.MEMSIC.COM

memSic

美新半导体



感知万物

数字化物理世界的 传导者

美新半导体是一家全球领先的半导体产品公司，主要从事 MEMS 传感器产品的研发、制造与销售,为客户提供从 MEMS 传感芯片、软件算法和应用方案的一站式解决方案。美新半导体目前大规模稳定量产全球独有热式加速度计、AMR 地磁传感器、电容式加速度计、低功耗霍尔开关等产品，广泛应用于汽车、工业、医疗、可穿戴、智能家居和消费电子。

AMR地磁传感器



全球最小尺寸



低噪声



高灵敏度



高精度



磁传感器历代产品



手机&平板



车载应用



无人机

MMC5603NJ
MMC5633NJ
单片集成的3轴磁传感器
基于先进的AMR技术
晶圆级封装, 封装尺寸: $0.8 \times 0.8 \times 0.4\text{mm}$
MMC5633NJ全面支持I3C接口



MMC3630KJ
工艺成熟, 性能稳定可靠
封装尺寸: $1.2 \times 1.2 \times 0.5\text{mm}$



MMC5983MA
MMC3416xPJ
温漂低、噪声低、磁滞小、精度高
可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强、
良率高、易于校正
车规级产品MMC5983MA和MMC5893VA通过
AEC-Q100 Grade 2认证
MMC3416X超低功耗、支持多至8个I2C地址



热式加速度传感器



极耐冲击



超小尺寸



超低温漂

MXC4005XC
MXC6655XA
单片集成, 晶圆级封装, 超小尺寸, 性能稳定, 良率高
用于手机、平板等消费类电子设备
MXC4005XC封装尺寸: $1.2 \times 1.7 \times 0.95\text{mm}$
MXC6655XA封装尺寸: $2 \times 2 \times 1\text{mm}$



MXD2020EL
MXD6235Q
2轴单片集成
PWM数字输出
MXD2020EL的量程 $\pm 1\text{g}$, 噪声 $0.2\text{mg}/\sqrt{\text{Hz}}$
MXD6235Q的量程 $\pm 1.5\text{g}$, 噪声 $0.13\text{mg}/\sqrt{\text{Hz}}$
用于水平尺、家电以及其它工业类应用
封装尺寸: $5.5 \times 5.5 \times 2\text{mm}$



MXR7150VW
MXR7999VW
2轴单片集成, offset和灵敏度在芯片内做温度补偿,
平/竖双贴封装, 安装灵活
模拟输出, MXR7999VW的量程 $\pm 2\text{g}$, 灵敏度 1000mV/g ,
MXR7150VW的量程 $\pm 13.3\text{g}$, 灵敏度 150mV/g
产品通过车规AEC-Q100 Grade 1认证, 用于汽车主动悬挂
系统、ESC和EPB系统
封装尺寸: $5.5 \times 5.5 \times 2.7\text{mm}$



MXP7205VW
2轴单片集成, offset和灵敏度在芯片内做温度补偿,
平/竖双贴封装, 安装灵活
SPI数字输出, 量程 $\pm 5\text{g}$, 灵敏度 800LSB/g
产品通过车规AEC-Q100 认证, 用于汽车ESC和EPB系统
封装尺寸: $5.5 \times 5.5 \times 2.7\text{mm}$



电容式加速度传感器



超低功耗

休眠: $0.1\mu\text{A}$
嗅探: $0.4\mu\text{A}$ @6Hz
工作: $0.9\mu\text{A}$ @25Hz



极小尺寸

$1.29 \times 1.09 \times 0.74\text{mm}$ 8-ball WLCSP
 $1.6 \times 1.6 \times 0.94\text{mm}$ 10-pin LGA



丰富的功能及算法支持

单击/双击, 硬件计步
倾斜、移动检测



MC3416
16位高分辨率, 支持I2C/SPI通讯方式
低噪声, 低零偏, 低温漂
封装尺寸: $\text{LGA-12 } 2 \times 2 \times 0.95\text{mm}$



MC3419
MC3479
16位高分辨率, 支持I2C/SPI通讯方式, 带FIFO缓存
低噪声, 低零偏, 低温漂
封装尺寸: $\text{LGA-12 } 2 \times 2 \times 0.95\text{mm}$



MXD6100HG
MXD6101HG
16位高分辨率, 支持I2C/SPI通讯方式, 带FIFO缓存
支持双击中断, 低噪声, 低零偏, 低温漂
封装尺寸: $\text{LGA-12 } 2 \times 2 \times 0.95\text{mm}$



MC3630
MC3632
MC3635
14位分辨率, 支持I2C/SPI通讯方式, 带FIFO缓存
超低功耗, 支持多种低功耗模式
封装尺寸: $\text{LGA-12 } 2 \times 2 \times 0.95\text{mm}$
MC3635 封装尺寸: $\text{LGA-10 } 1.6 \times 1.6 \times 0.94\text{mm}$



MC3672
14位分辨率, 支持I2C/SPI通讯方式, 带FIFO缓存
超小尺寸, 超低功耗, 支持多种低功耗模式
封装尺寸: $\text{CSP-8 } 1.29 \times 1.08 \times 0.74\text{mm}$



MXC3500AL
16bit分辨率, 支持I2C/SPI通讯方式
1.5KB超大FIFO缓存, 多种低功耗模式
单/双/三击中断, 硬件计步
封装尺寸: $\text{LGA-12 } 2 \times 2 \times 0.73\text{mm}$



霍尔传感器



超低功耗



极小的封装尺寸
丰富的封装类型



超宽输入电压范围



精准的开关控制



MHA100KN
全极双输出, 超低功耗, 灵敏度高
封装尺寸: $\text{DFN-4 } 1.0 \times 1.4 \times 0.37\text{mm}$



MHA150N/S
单极输出, 超低功耗, 灵敏度高
封装尺寸: $\text{SOT23-3L } 2.9 \times 1.6 \times 1.1\text{mm}$



MHA160N/S
单极输出, 超低功耗, 灵敏度高
封装尺寸: $\text{SOT553 } 1.6 \times 1.2 \times 0.55\text{mm}$

